

第 126 期  
中間報告書

平成28年4月1日から平成28年9月30日まで

株主の皆様へ



住友ベークライト株式会社

## 株主の皆様へ



平素は格別のご支援とご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
ここに第126期第2四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）の事業の概況等について、ご報告申し上げます。

平成28年11月 代表取締役社長

林 茂

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国および欧州では緩やかながら景気回復が続きましたが、中国をはじめ新興国では引き続き減速基調で推移し、日本経済も個人消費が伸びず、企業収益や設備投資の改善の動きにも力強さが無いなど、景気は足踏みの状況が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においては、パソコン向けの低迷が続く中、スマートフォンなどの多機能携帯端末用途の新興国を中心とした需要に支えられ、全体としては堅調に推移しました。自動車においては、北米の新車販売は引き続き高水準を維持しており、欧州も前年を上回る状況が続き、中国でも小型車減税期限前の駆け込み需要で盛り上がりを見せました。国内では軽自動車の販売の落ち込みが長引き、低調でした。国内の住宅着工件数は、持ち直しが一服し、わずかな回復にとどまりました。

当社グループは、このような経営環境の中、「CS（Customer Satisfaction、顧客満足）最優先」を事業活動の基本方針とし、社内外の連携・協業を積極的に行うことにより、市場のニーズを掘り起こし、個人・組織・会社全体の力を結集し、さらには構造改革にも着手して事業体質の転換を図りながら、持続的な成長に向けて、次の基本戦略を掲げて取り組んでまいりました。

- ① 新製品の早期立ち上げ、創生
- ② 既存事業の再生、事業転換
- ③ 成長分野の収益力強化、規模拡大

この結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は、円高

による売上高の下押しや原料安に伴う売値下げなどの影響があり、973億92百万円と、前年同期比で7.8%、82億16百万円の減収となりました。損益につきましては、連結営業利益は円高が悪化要因になりましたが、半導体関連材料の販売数量増加や構造改革による販売内容構成の好転、さらには昨年より取り組んでまいりました固定費削減効果などが寄与し、前年同期比で51.2%増加し72億78百万円となり、連結経常利益も前年同期比で49.1%増加し74億94百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比で148.2%増加し52億46百万円となりました。

中間配当金につきましては、1株につき5円とさせていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

今後の経済動向につきましては、米国や欧州経済の回復基調の継続が期待される一方、中国をはじめ新興国経済は景気減速が懸念されるなど先行き不透明感があり、日本経済も企業業績の悪化や原材料価格の上昇、円高の進行など予断を許さない状況にあります。

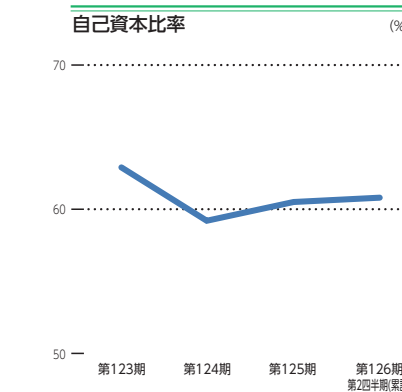
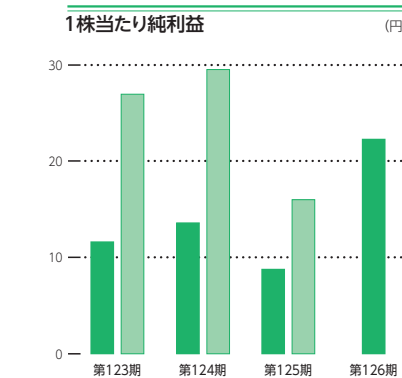
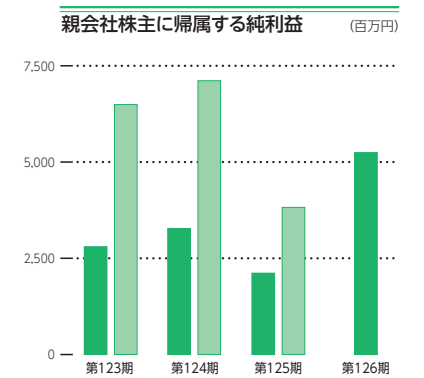
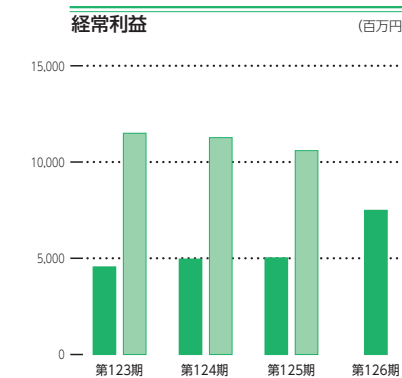
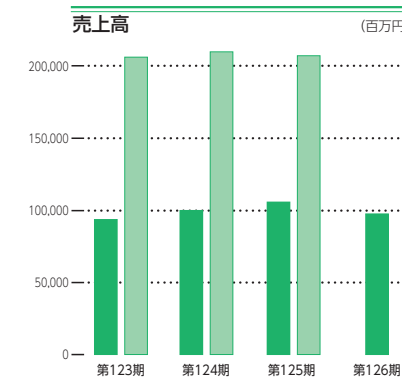
このような事業環境のもと、当社は引き続き「CS最優先」を基本とし、既存事業の再生や事業転換を図り、成長領域に経営資源を集中して収益力の強化、規模の拡大に努め、新規事業・新製品の迅速な立ち上げ・創生により、持続的な成長を目指して取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

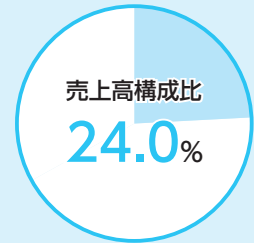
## 連結業績ハイライト

	第123期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)		第124期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)		第125期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)		第126期 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで)	
	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	
売上高 (百万円)	93,520	206,047	99,784	209,659	105,608	206,956	97,392	
経常利益 (百万円)	4,555	11,498	4,960	11,263	5,025	10,598	7,494	
親会社株主に帰属する純利益 (百万円)	2,802	6,493	3,275	7,113	2,114	3,828	5,246	
1株当たり純利益 (円)	11.63	26.96	13.60	29.53	8.78	16.01	22.29	
自己資本比率 (%)	61.8	62.9	56.8	59.2	60.4	60.5	60.8	

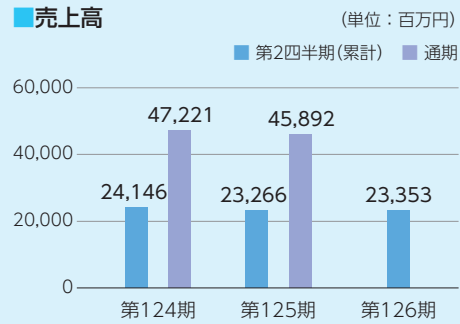
■ 第2四半期(累計) ■ 通期



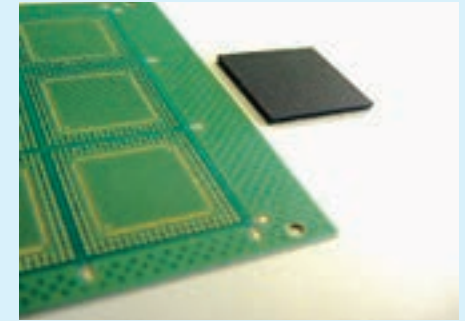
### 半導体関連材料部門



売上高 **23,353**百万円  
前年同期比 **+0.4%**



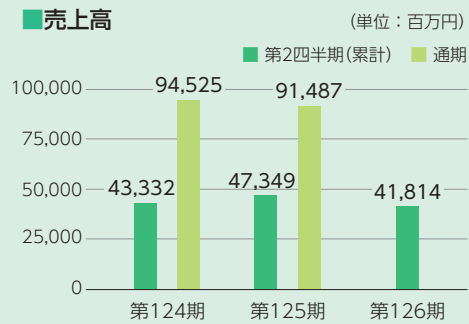
半導体封止用エポキシ樹脂成形材料は、スマートフォンなど多機能携帯端末向けで販売数量を伸ばしたものの、円高の影響などにより、売上高は若干の増加となりました。半導体パッケージ基板材料の「LαZ®」は、中国系スマートフォン向けを中心とした拡販に取り組んでおり、売上高は増加しました。



### 高機能プラスチック部門



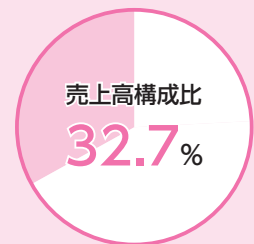
売上高 **41,814**百万円  
前年同期比 **-11.7%**



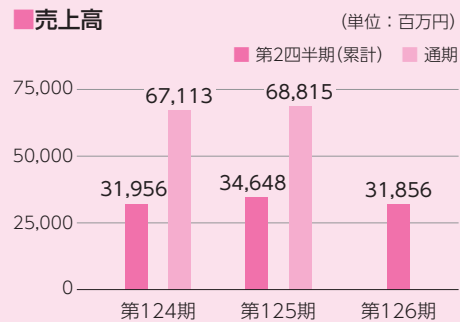
フェノール樹脂成形材料および工業用フェノール樹脂は、北米および欧州の自動車用途が伸びましたが、円高および原料安に伴う売価是正などが影響し、売上高は減少しました。航空機・自動車等成形品は、航空機関連が伸長したものの、円高の影響などにより、売上高は減少しました。銅張積層板は、フェノール樹脂銅張積層板の片面板事業の縮小の影響や家電用途の低迷などにより、売上高は減少しました。



### クオリティオブライフ関連製品部門



売上高 **31,856**百万円  
前年同期比 **-8.1%**



医療機器製品は、戦略製品の血管内治療デバイス「ステアリングマイクロカテーテル」は国内外とも順調に実績を重ねましたが、既存製品において顧客での在庫調整が長引くなど、売上高は減少しました。ビニル樹脂シートおよび複合シートは、医薬品包装用途がジェネリック薬向けを中心に堅調に推移し、鮮度保持フィルム「P-プラス®」も産地野菜用途などで新規採用が進みましたが、カバーテープなどの産業用フィルムが低迷し、売上高は減少しました。ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板のプレート製品は、サンレンズ用偏光板や電子機器用絶縁材が低調で、売上高は減少しました。なお、デコラ製品は、本年3月末に不採算品目の高圧メラミン化粧板および不燃メラミン化粧板から撤退したことにより、売上高は減少しましたが、損益は大幅に改善しました。引き続き鉄道車両内装材や業界最薄の不燃メラミン化粧シート「デコラインベア®」などの高機能・高付加価値分野に特化した新たな事業展開を図っております。防水関連製品は、マンション向けが好調で、蓄熱槽も伸びており、売上高は増加しました。



その他につきましては、売上高は368百万円となりました。

# 連結財務諸表

## ● 連結貸借対照表

科目	前期末 (平成28年3月31日現在)	当第2四半期末 (平成28年9月30日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	<b>123,514</b>	<b>118,601</b>
現金及び預金	44,876	44,604
受取手形及び売掛金	41,783	40,548
商品及び製品	12,529	11,204
半製品	3,754	3,481
仕掛品	1,367	1,348
原材料及び貯蔵品	11,438	11,097
その他	7,819	6,367
貸倒引当金	△ 55	△ 50
<b>固定資産</b>	<b>136,607</b>	<b>125,957</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>87,325</b>	<b>81,800</b>
建物及び構築物（純額）	31,967	30,078
機械装置及び運搬具（純額）	39,072	35,512
その他（純額）	16,285	16,208
<b>無形固定資産</b>	<b>26,446</b>	<b>23,122</b>
のれん	24,318	21,357
その他	2,128	1,765
<b>投資その他の資産</b>	<b>22,836</b>	<b>21,034</b>
<b>資産合計</b>	<b>260,122</b>	<b>244,558</b>

(単位：百万円)

科目	前期末 (平成28年3月31日現在)	当第2四半期末 (平成28年9月30日現在)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	<b>56,068</b>	<b>50,117</b>
支払手形及び買掛金	26,115	26,107
短期借入金	4,879	5,252
コマーシャル・ペーパー	9,000	4,000
未払法人税等	2,870	2,680
賞与引当金	2,730	2,643
事業再建費用引当金	1,088	49
その他	9,384	9,384
<b>固定負債</b>	<b>45,145</b>	<b>44,134</b>
長期借入金	37,018	36,776
退職給付に係る負債	4,333	3,842
その他の引当金	82	82
その他	3,710	3,434
<b>負債合計</b>	<b>101,213</b>	<b>94,252</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>	<b>146,300</b>	<b>150,368</b>
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	88,548	84,602
自己株式	△ 14,748	△ 6,735
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>11,018</b>	<b>△ 1,571</b>
その他有価証券評価差額金	5,206	4,964
為替換算調整勘定	6,551	△ 5,881
退職給付に係る調整累計額	△ 739	△ 654
<b>非支配株主持分</b>	<b>1,589</b>	<b>1,509</b>
<b>純資産合計</b>	<b>158,908</b>	<b>150,305</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>260,122</b>	<b>244,558</b>

## ● 連結損益計算書

科目	前第2四半期累計 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	当第2四半期累計 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで)
<b>売上高</b>	<b>105,608</b>	<b>97,392</b>
<b>売上原価</b>	<b>75,483</b>	<b>66,735</b>
<b>売上総利益</b>	<b>30,124</b>	<b>30,657</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>25,310</b>	<b>23,378</b>
<b>営業利益</b>	<b>4,813</b>	<b>7,278</b>
<b>営業外収益</b>	<b>739</b>	<b>526</b>
受取利息	151	92
受取配当金	218	208
持分法による投資利益	95	95
為替差益	187	—
雑収入	86	129
<b>営業外費用</b>	<b>528</b>	<b>311</b>
支払利息	152	124
租税公課	229	—
為替差損	—	30
雑損失	146	156
<b>経常利益</b>	<b>5,025</b>	<b>7,494</b>
<b>特別利益</b>	<b>1,137</b>	<b>252</b>
固定資産売却益	8	4
投資有価証券売却益	724	247
受取保険金	403	—
<b>特別損失</b>	<b>1,902</b>	<b>193</b>
固定資産除売却損	105	181
投資有価証券評価損	—	10
事業再建関連費用	196	—
災害による損失	250	—
減損損失	1,302	—
その他	46	1
<b>税金等調整前四半期純利益</b>	<b>4,259</b>	<b>7,553</b>
<b>法人税等</b>	<b>2,075</b>	<b>2,163</b>
法人税、住民税及び事業税	2,045	1,685
法人税等調整額	30	477
<b>四半期純利益</b>	<b>2,183</b>	<b>5,390</b>
非支配株主に帰属する四半期純利益	69	143
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,114	5,246

## ● 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前第2四半期累計 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	当第2四半期累計 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>7,474</b>	<b>11,331</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 3,442</b>	<b>△ 2,266</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 5,967</b>	<b>△ 6,068</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>32</b>	<b>△ 3,574</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</b>	<b>△ 1,902</b>	<b>△ 578</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>49,966</b>	<b>44,868</b>
<b>連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</b>	<b>252</b>	<b>—</b>
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>48,316</b>	<b>44,290</b>

## 会社情報 (平成28年9月30日現在)

### 会社概要

設立 昭和7年1月25日

資本金 37,143,093,785円

従業員数 6,149名 (連結)

主要な事業内容 下記製品等の製造・販売

#### 半導体関連材料部門

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料  
感光性ウエハーコート用液状樹脂  
半導体用液状樹脂  
半導体基板材料

#### 高機能プラスチック部門

フェノール樹脂成形材料  
工業用フェノール樹脂  
成形品  
合成樹脂接着剤  
エポキシ樹脂銅張積層板  
フェノール樹脂銅張積層板  
航空機内装部品

#### クオリティオブライフ関連製品部門

医療機器製品  
ビニル樹脂シートおよび複合シート  
メラミン樹脂化粧板・化粧シート  
ポリカーボネート樹脂板  
塩化ビニル樹脂板  
防水工事の設計ならびに施工請負  
鮮度保持フィルム  
バイオ製品

### 事業所

本社	東京都品川区
研究所	コーポレートR&Dセンター (神戸市・宇都宮市) コーポレートエンジニアリングセンター (藤枝市) HPP技術開発研究所 (藤枝市) フィルム・シート研究所 (尼崎市) プレート研究所 (鹿沼市) 電子デバイス材料研究所 (直方市)
工場	尼崎工場 (尼崎市) 鹿沼工場 (鹿沼市) 静岡工場 (藤枝市) 宇都宮工場 (宇都宮市)

### 取締役および監査役

※社長	林 寺 沢 常 茂	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊 之 雄 三 保 夫 司 子
※取締役	寺 武 山 藤 稻 朝 阿 松 小 八 赤 富 小	沢 藤 脇 原 垣 隈 部 田 川 幡 坂 田 泉
取締役		
取締役		
取締役		
社外取締役		
社外取締役		
社外取締役		
常勤監査役		
常勤監査役		
社外監査役		
社外監査役		

(注) ※印は代表取締役であります。

### 執行役員

社長執行役員	林 寺 沢 常 茂	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
副社長執行役員	寺 武 山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
副社長執行役員	寺 武 山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
専務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
専務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
常務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
常務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
常務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
常務執行役員	山 藤 稻 朝	茂 夫 樹 昇 彦 幸 俊
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭
執行役員	桑 小 鈴 鈴 長 文 竹 倉	剛 一 淳 清 浩 雅 義 圭

## 株式情報 (平成28年9月30日現在)

### 株式の状況

株式の種類	普通株式
単元株式数	1,000株
発行可能株式総数	800,000,000株
発行済株式総数	247,952,394株
株主数	14,466名
うち単元株主数	10,281名

(注) 平成28年4月14日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式総数が前期末と比べて15,000,000株減少しております。

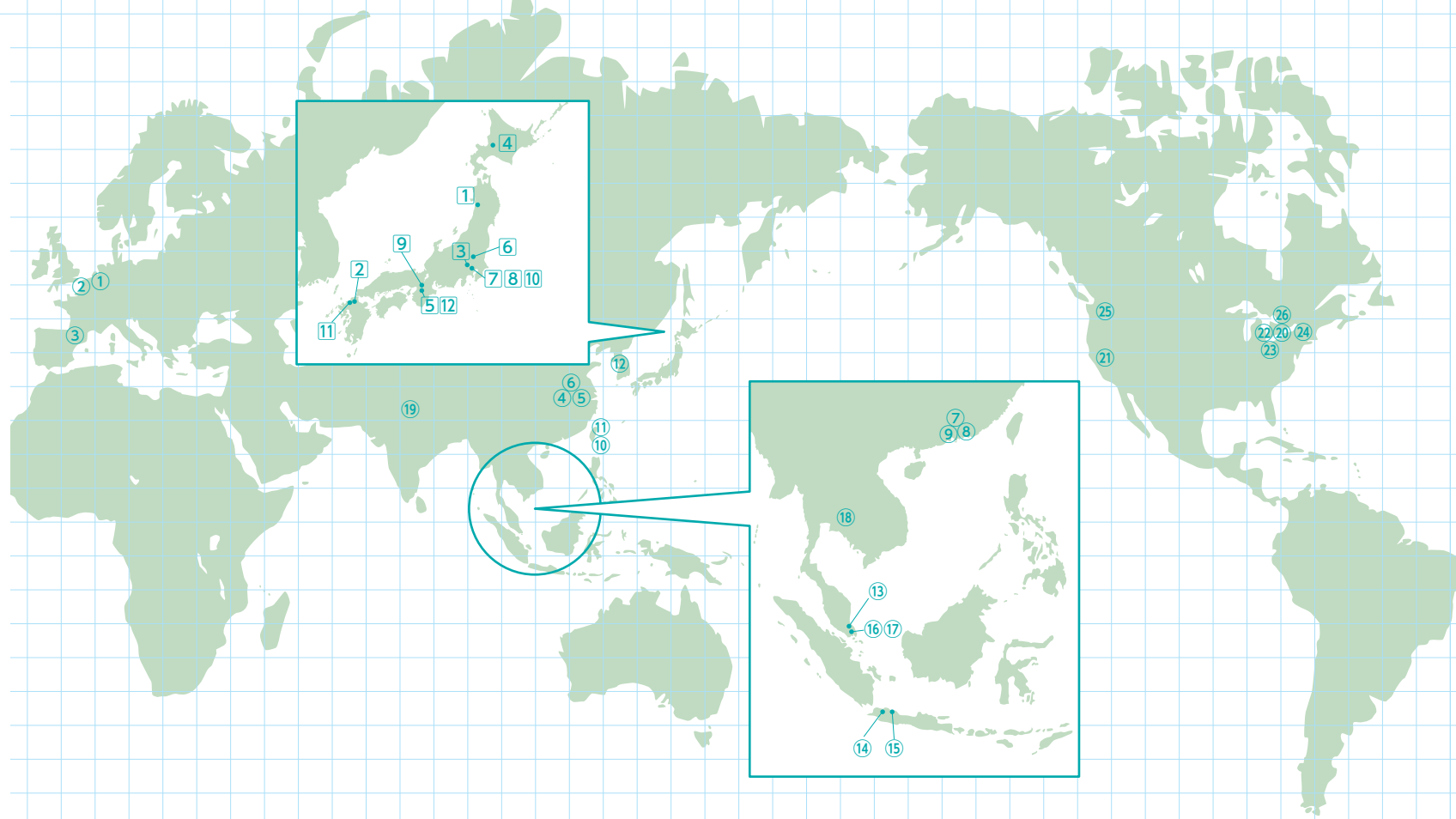
### 大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
住友化学株式会社	52,549	22.33
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	9,249	3.93
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	9,130	3.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	8,670	3.68
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	5,881	2.50
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	5,651	2.40
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・三井住友信託退給口	4,366	1.86
株式会社三井住友銀行	4,360	1.85
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	3,607	1.53
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY	3,524	1.50

(注) 1. 当社は自己株式12,606千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。  
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。

● 海外

- ① N.V. SUMITOMO BAKELITE EUROPE S.A.
- ② VYNCOLIT N.V.
- ③ SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA), S.L.U.
- ④ 蘇州住友電木有限公司
- ⑤ 上海住友電木有限公司
- ⑥ 南通住友電木有限公司
- ⑦ 東莞住友電木有限公司
- ⑧ 住友倍克 (香港) 有限公司
- ⑨ 住友倍克澳門有限公司
- ⑩ 台湾住友培科股份有限公司
- ⑪ 台湾住培股份有限公司
- ⑫ SUMIBE KOREA CO., LTD.
- ⑬ SNC INDUSTRIAL LAMINATES SDN. BHD.
- ⑭ P.T. INDOPHERIN JAYA
- ⑮ P.T. SBP INDONESIA
- ⑯ SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE PTE. LTD.
- ⑰ SUMIDUREZ SINGAPORE PTE. LTD.
- ⑱ SUMITOMO BAKELITE (THAILAND) CO., LTD.
- ⑲ SBE INDIA PVT. LTD.
- ⑳ SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA HOLDING, INC.
- ㉑ SUMITOMO PLASTICS AMERICA, INC.
- ㉒ DUREZ CORPORATION
- ㉓ PROMERUS LLC
- ㉔ SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA, INC.
- ㉕ VAUPELL HOLDINGS, INC.
- ㉖ DUREZ CANADA CO., LTD.



● 国内

- ① 秋田住友バーク株式会社
- ② 九州住友バークライト株式会社
- ③ 住バテクノプラスチック株式会社
- ④ 北海大洋プラスチック株式会社
- ⑤ 山六化成工業株式会社
- ⑥ 住ベリサーチ株式会社
- ⑦ 株式会社サンバーク
- ⑧ 住ベシート防水株式会社
- ⑨ 株式会社ソフテック
- ⑩ 株式会社サンクストレーディング
- ⑪ 西部樹脂株式会社
- ⑫ 筒中興産株式会社

(注) 本中間報告書における金額、比率および株式数の表示方法は、次のとおりであります。ただし、「-」と表示している場合は「なし」を表しております。

1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 売上高および利益の増減比率は四捨五入により小数点第1位まで、持株比率は四捨五入により小数点第2位まで表示しております。
3. 千株単位の記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

## ■ 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	定時株主総会：毎年3月31日 期末配当金：毎年3月31日 中間配当金：毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
公告方法	電子公告により行います。 <a href="http://www.sumibe.co.jp">http://www.sumibe.co.jp</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	☎0120-782-031
ホームページ	<a href="http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html">http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html</a>

## お知らせ

### 1. 株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会につきましては、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

### 2. 除斥期間満了後のお取り扱いについて

配当金は、支払開始の日から満3年（除斥期間）を経過しますと、当社定款の規定によりお支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。

### 3. 特別口座について

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といえます。）を開設しております。特別口座についての住所変更等のお届出およびご照会は、上記の電話照会先をお願いいたします。



 住友ベークライト株式会社

東京都品川区東品川二丁目5番8号

ホームページ <http://www.sumibe.co.jp>



レスポンスブル・ケア®

